集成电路流片奖励

申报说明

一、申报条件

1.申报期内（2021年1月1日-2021年9月30日）开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），合同已执行完毕，并承诺在京开展该产品产业化工作；

2.申报本奖励的项目未获得其他市级财政资金的支持。

二、支持方式和标准

1.对开展多项目晶圆（MPW）流片的企业，按照年度流片费用50%予以奖励，每个企业最高不超过300万元；

2.对开展工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按产品流片费用的30%予以奖励，每个企业最高不超过1000万元；

3.对在京代工的工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，奖励比例50%，每个企业最高不超过2000万元。

附件：《北京市集成电路设计产品首轮流片奖励资金申报书》